

Приложение 6  
к приказу АНО НАРК

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям в сфере нанотехнологий и микроэлектроники

1. Наименование квалификации: Оператор элионных процессов изделий микроэлектроники 6-го разряда (4-й уровень квалификации)
2. Номер квалификации \_\_\_\_\_
3. Уровень (подуровень) квалификации 4
4. Область профессиональной деятельности: Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
5. Вид профессиональной деятельности: Выполнение элионных процессов при производстве изделий микроэлектроники
6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: протокол заседания СПК в сфере нанотехнологий и микроэлектроники от 21.06.2023 № 69.
7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: \_\_\_\_\_
8. Основание разработки квалификации: \_\_\_\_\_

Вид документа	Полное наименование и реквизиты документа
Профессиональный стандарт (при наличии)	«Оператор элионных процессов изделий микроэлектроники», приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «21» марта 2022 г. № 146н
Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии)	
Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	

## 9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

Код (при наличии профессионального стандарта)	Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности)	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Дополнительные сведения (при необходимости)
В/01.4	Подготовка мониторных (нерабочих) пластин для аттестации установок для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники	Подбор сопроводительного листа в соответствии с технологической инструкцией или выбор задачи в автоматизированной системе управления производством в соответствии с графиком периодической проверки готовности установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники	Работать на установке сортировки пластин (сортере) при изготовлении изделий микроэлектроники Определять вид периодической аттестации оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники, в соответствии с графиком периодической проверки Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники	Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники Расположение технологических установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники	
		Подготовка мониторных (нерабочих) пластин в соответствии с технологической инструкцией проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники	Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при	Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий	

			изготовлении изделий микроэлектроники Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники	микроэлектроники Правила работы персонала в чистых производственных помещениях	
		Регистрация партии мониторных пластин в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники	Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники	Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы персонала в чистых производственных помещениях	
		Перемещение контейнера с мониторными пластинами на загрузочное устройство установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники	Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с вакуумным и	Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при	

			щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве	изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы персонала в чистых производственных помещениях Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве	
В/02.4	Проведение обработки мониторных (нерабочих) пластин на установках специализированного типа для проведения элионных процессов	Подготовка установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления к проведению технологических операций по обработке мониторных пластин при изготовлении изделий микроэлектроники	Работать на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с балластными пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий	Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники План расположения технологических установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники Требования охраны труда при работе на установках и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с автоматизированной системой управления	

			<p>микроэлектроники</p> <p>Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок при ведении элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве</p>	<p>производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве</p>	
	Загрузка мониторных пластин в технологическое оборудование, используемое при изготовлении изделий микроэлектроники, в ручном и автоматическом режиме	<p>Работать на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с балластными пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Требования охраны труда при работе на установках и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники</p>		

				Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники	
		Настройка параметров установок в соответствии с требованиями технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники	<p>Работать на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять контроль работы установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники, с помощью средств мониторинга в составе оборудования</p> <p>Вносить разрешенные изменения в параметры технологических процессов при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных</p>	<p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Операционные универсальные карты по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения, используемые для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве</p>	

			<p>(нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Обеспечивать безопасную эксплуатацию установок при ведении элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве</p>		
		<p>Обработка мониторных пластин в ручном и автоматическом режиме на установках специализированного типа для проведения элионных процессов</p>	<p>Работать с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять контроль работы установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники, с помощью средств мониторинга в составе оборудования</p> <p>Вносить разрешенные изменения в параметры технологических процессов при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Обеспечивать безопасную</p>	<p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Операционные универсальные карты по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения, используемые для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p>	

			эксплуатацию установок при ведении элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники Определять момент окончания элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники	Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве	
	Запуск партии мониторинговых пластин, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники, с помощью автоматизированной системы управления производством	Работать с мониторинговыми (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с вакуумным и щипковым пинцетом при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторинговых (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники		Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники Операционные универсальные карты по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения, используемые для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы персонала в чистых производственных помещениях Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве	
	Заполнение	Работать в	Операционные		



		<p>сопроводительных листов при проведении аттестации технологического оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>универсальные карты по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения, используемые для проведения элионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p>	
		<p>Выгрузка обработанных monitorных пластин из установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Работать на установках плазмохимического травления, ионного легирования, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с monitorными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки monitorных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий</p>	<p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с monitorными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с балластными пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки monitorных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	

			микроэлектроники	Требования охраны труда при работе на установках и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники	
		Передача партии мониторинговых пластин далее по аттестационному маршруту согласно сопроводительному листу или задаче в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники	Работать в автоматизированной системе управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники	План расположения технологических установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники Операционные универсальные карты по выполнению технологических операций на установках плазмохимического травления, ионного легирования, вакуумного напыления и осаждения, используемые для проведения эллионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники Правила работы персонала в чистых производственных	

				помещениях	
В/03.4	<p>Определение готовности к работе установок специализированного типа для проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники</p>	<p>Проверка технической готовности измерительного оборудования контроля дефектности, толщины слоев и поверхностного сопротивления, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Определять техническое состояние измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процессов измерения при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Пользоваться автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Изменять статус технологических установок в автоматизированной системе управления производством (с работоспособного на неработоспособное состояние и обратно) согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий</p>	<p>Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>План расположения технологического и измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	

			<p>микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве</p>	<p>Требования охраны труда при работе на измерительном оборудовании и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Расположение технологических установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве</p>	
		<p>Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля дефектности, используемое при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Работать на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процессов измерения при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми</p>	<p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	

			<p>при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве</p>	<p>Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Требования охраны труда при работе на измерительном оборудовании и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p>	
		<p>Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля толщины слоев, используемое при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Работать на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процессов измерения при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения</p>	

			<p>Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве</p>	<p>и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Требования охраны труда при работе на измерительном оборудовании и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p>	
		<p>Перемещение мониторных пластин на измерительное оборудование контроля поверхностного сопротивления, используемое при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Работать на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Обеспечивать безопасную эксплуатацию измерительного оборудования при ведении процессов измерения при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и</p>	<p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих)</p>	

			<p>транспортировки мониторинговых (нерабочих) пластин, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетом при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве</p>	<p>пластин при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Требования охраны труда при работе на измерительном оборудовании и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p>	
		<p>Проведение контроля параметров мониторинговых пластин на измерительном оборудовании в соответствии с операционной картой при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Определять техническое состояние измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Анализировать результаты измерения мониторинговых (нерабочих) пластин на соответствие плану контроля установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Пользоваться автоматизированной системой управления производством при</p>	<p>Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила эксплуатации измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с мониторинговыми (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с вакуумным</p>	

			<p>изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Определять средние, максимальные и минимальные значения, разброс параметров при проведении измерений на мониторинжных пластинах при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с мониторинжными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторинжных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Оказывать первую помощь пострадавшему на производстве</p>	<p>и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторинжных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Требования охраны труда при работе на измерительном оборудовании и правила пожарной безопасности при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок действий при отклонении параметров технологических процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Операционные универсальные карты по выполнению измерительных операций на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок оказания первой</p>	
--	--	--	--	--	--



				помощи пострадавшему на производстве	
		Запись результатов измерения параметров мониторинговых пластин в карту сбора информации при изготовлении изделий микроэлектроники	<p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Анализировать результаты измерения мониторинговых (нерабочих) пластин на соответствие плану контроля установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Изменять статус технологических установок в автоматизированной системе управления производством (с работоспособного на неработоспособное состояние и обратно) согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники</p> <p>Определять средние, максимальные и минимальные значения, разброс параметров при проведении измерений на мониторинговых пластинах при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок действий при отклонении параметров технологических процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Операционные универсальные карты по выполнению измерительных операций на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	
		Выполнение плана действий при отклонении параметров эионных процессов при изготовлении изделий микроэлектроники	Определять техническое состояние измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники	Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления,	

			<p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Анализировать результаты измерения мониторинговых (нерабочих) пластин на соответствие плану контроля установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Изменять статус технологических установок в автоматизированной системе управления производством (с работоспособного на неработоспособное состояние и обратно) согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники</p> <p>Определять средние, максимальные и минимальные значения, разброс параметров при проведении измерений на мониторинговых пластинах при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок действий при отклонении параметров технологических процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Операционные универсальные карты по выполнению измерительных операций на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве</p>	
		<p>Ввод результатов измерения параметров мониторинговых пластин в автоматизированную систему управления производством или внесение полученных результатов аттестационных процессов в карты статистического управления при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Определять техническое состояние измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Анализировать результаты измерения мониторинговых</p>	<p>Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок действий при отклонении параметров технологических процессов</p>	

			<p>(нерабочих) пластин на соответствие плану контроля установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Пользоваться автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Определять средние, максимальные и минимальные значения, разброс параметров при проведении измерений на мониторинговых пластинах при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Операционные универсальные карты по выполнению измерительных операций на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	
		<p>Перевод установок в работоспособное состояние для проведения эионных процессов производства изделий микроэлектроники</p>	<p>Определять техническое состояние измерительного оборудования, используемого при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Осуществлять ввод данных в автоматизированную систему управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Анализировать результаты измерения мониторинговых (нерабочих) пластин на соответствие плану контроля установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Пользоваться автоматизированной системой</p>	<p>Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок действий при отклонении параметров технологических процессов ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Расположение технологических установок,</p>	

			<p>управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Изменять статус технологических установок в автоматизированной системе управления производством (с работоспособного на неработоспособное состояние и обратно) согласно технологической документации по изготовлению изделий микроэлектроники</p>	<p>используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Операционные универсальные карты по выполнению измерительных операций на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве</p>	
		<p>Перегрузка использованных мониторных пластин в накопитель (коллектор), используемый при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Анализировать результаты измерения мониторных (нерабочих) пластин на соответствие плану контроля установок, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Пользоваться автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Определять средние, максимальные и минимальные значения, разброс параметров при проведении измерений на мониторных пластинах при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>Требования плана контроля установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, используемых при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с мониторными (нерабочими) пластинами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с кассетами</p>	

			<p>Выполнять работы с мониторными (нерабочими) пластинами, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Выполнять работы с кассетами и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин, используемыми при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Работать с вакуумным и щипковым пинцетами при изготовлении изделий микроэлектроники</p>	<p>и контейнерами для хранения и транспортировки мониторных (нерабочих) пластин при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы с автоматизированной системой управления производством при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Правила работы персонала в чистых производственных помещениях</p> <p>Операционные универсальные карты по выполнению измерительных операций на измерительном оборудовании при изготовлении изделий микроэлектроники</p> <p>Порядок оказания первой помощи пострадавшему на производстве</p>	
--	--	--	---	--	--

#### 10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т.п.	Документ, цифровой ресурс	Код по документу (ресурсу)	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)
Оператор эсионных процессов 6-го разряда Старший оператор	ОКЗ	8189	Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы
	ОКПДТР	16211	Оператор эсионных процессов
	ЕТКС	§ 36, выпуск 20	Оператор эсионных процессов 6-го разряда
	ОКСО	2.11.01.10	Оператор оборудования эсионных процессов

### 11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости – направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты): среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты): не менее одного года оператором элионных процессов 5-го разряда.

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты): –

### 12. Особые условия допуска к работе:

Лица не моложе 18 лет.

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности.

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда.

### 13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии): –

### 14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1) Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Оператор оборудования элионных процессов».

2) Документ, подтверждающий опыт практической работы оператором элионных процессов 5-го разряда не менее одного года

или

1) Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования (непрофильного) или высшего образования.

2) Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки по профилю деятельности.

3) Документ, подтверждающий опыт практической работы оператором элионных процессов 5-го разряда не менее одного года

### 15. Срок действия свидетельства: 3 года.